



中华人民共和国国家标准

GB/T 18334—2025

代替 GB/T 18334—2001

挠性多层印制板规范

Specification for flexible multilayer printed boards

2025-10-31 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 应用等级 2

5 要求 2

 5.1 通则 2

 5.2 文件优先顺序 2

 5.3 材料 2

 5.4 设计 4

 5.5 外观和尺寸 4

 5.6 结构完整性 11

 5.7 物理性能 19

 5.8 化学性能 21

 5.9 电气性能 22

 5.10 环境性能 23

 5.11 其他要求 23

6 质量保证规定 23

 6.1 通则 23

 6.2 检验条件 24

 6.3 能力批准 24

 6.4 鉴定批准 24

 6.5 质量一致性检验 26

7 交货准备 32

 7.1 包装要求 32

 7.2 运输 32

 7.3 贮存 32

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 18334—2001《有贯穿连接的挠性多层印制板规范》。本文件与 GB/T 18334—2001 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围(见第1章,2001年版的第1章)；
- 增加了术语和定义(见第3章)；
- 增加了应用等级(见第4章)；
- 增加了文件采用的优先顺序(见5.2)；
- 增加了材料的规定(见5.3)；
- 增加了设计的要求(见5.4)；
- 增加了模拟返工的要求(见5.7.8)；
- 增加了清洁度的规定(见5.8.2)；
- 增加了湿热绝缘电阻的规定(见5.9.3)；
- 增加了振动的规定(见5.10.2)；
- 增加了其他性能的规定(见5.11)；
- 增加了质量保证规定(见第6章)；
- 增加了交货准备的规定(见第7章)；
- 删除了测试图形——测试板(见2001年版的第7章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC 47)归口。

本文件起草单位：深圳崇达多层线路板有限公司、中国电子技术标准化研究院、深南电路股份有限公司、生益电子股份有限公司、江苏广信感光新材料股份有限公司、瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司、福莱盈电子股份有限公司、广州广合科技股份有限公司、惠州中京电子科技有限公司、广东成德电子科技有限公司、博敏电子股份有限公司、中国电子电路行业协会、深圳市景旺电子股份有限公司、深圳市三德冠精密电路科技有限公司、珠海崇达电路技术有限公司。

本文件主要起草人：宋建远、薛超、戴炯、任尧儒、朱民、袁林辉、皇甫铭、黎钦源、黄生荣、刘镇权、陈世金、洪芳、张霞、张道兵、郭兴波。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2001年首次发布为 GB/T 18334—2001；
- 本次为第一次修订。

挠性多层印制板规范

1 范围

本文件规定了挠性多层印制板的要求、质量保证和交货准备,并描述了相应的检验方法。
本文件适用于挠性多层印制板的设计、生产和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2036 印制电路术语

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12 h+12 h 循环)

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分:试验方法 试验 N:温度变化

GB/T 2423.58 电工电子产品环境试验 第2-80部分:试验方法 试验 Fi:振动 混合模式

GB/T 2523 冷轧金属薄板和薄带表面粗糙度、峰值数和波纹度测量方法

GB/T 4588.3 印制板的设计和使用

GB/T 4677—2002 印制板测试方法

GB/T 4725 印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板

GB/T 5230 印制板用电解铜箔

GB/T 13555 挠性印制电路用聚酰亚胺薄膜覆铜板

GB/T 13556 挠性印制电路用聚酯薄膜覆铜板

GB/T 13557—2017 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法

GB/T 14708 挠性印制电路用涂胶聚酯薄膜

GB/T 14709 挠性印制电路用涂胶聚酰亚胺薄膜

GB/T 16261—2017 印制板总规范

GB/T 20422 无铅钎料

GB/T 33015 多层印制板用粘结片通用规则

GB/T 35575 电磁屏蔽薄膜通用技术要求

SJ/T 10309 印制板用阻焊剂

SJ 20810 印制板尺寸与公差

SJ 20828 合格鉴定用测试图形和布设总图

YS/T 421 间接排版印刷版基用铝板、带、箔材

YS/T 1039 挠性印制线路板用压延铜箔

3 术语和定义

GB/T 2036 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。